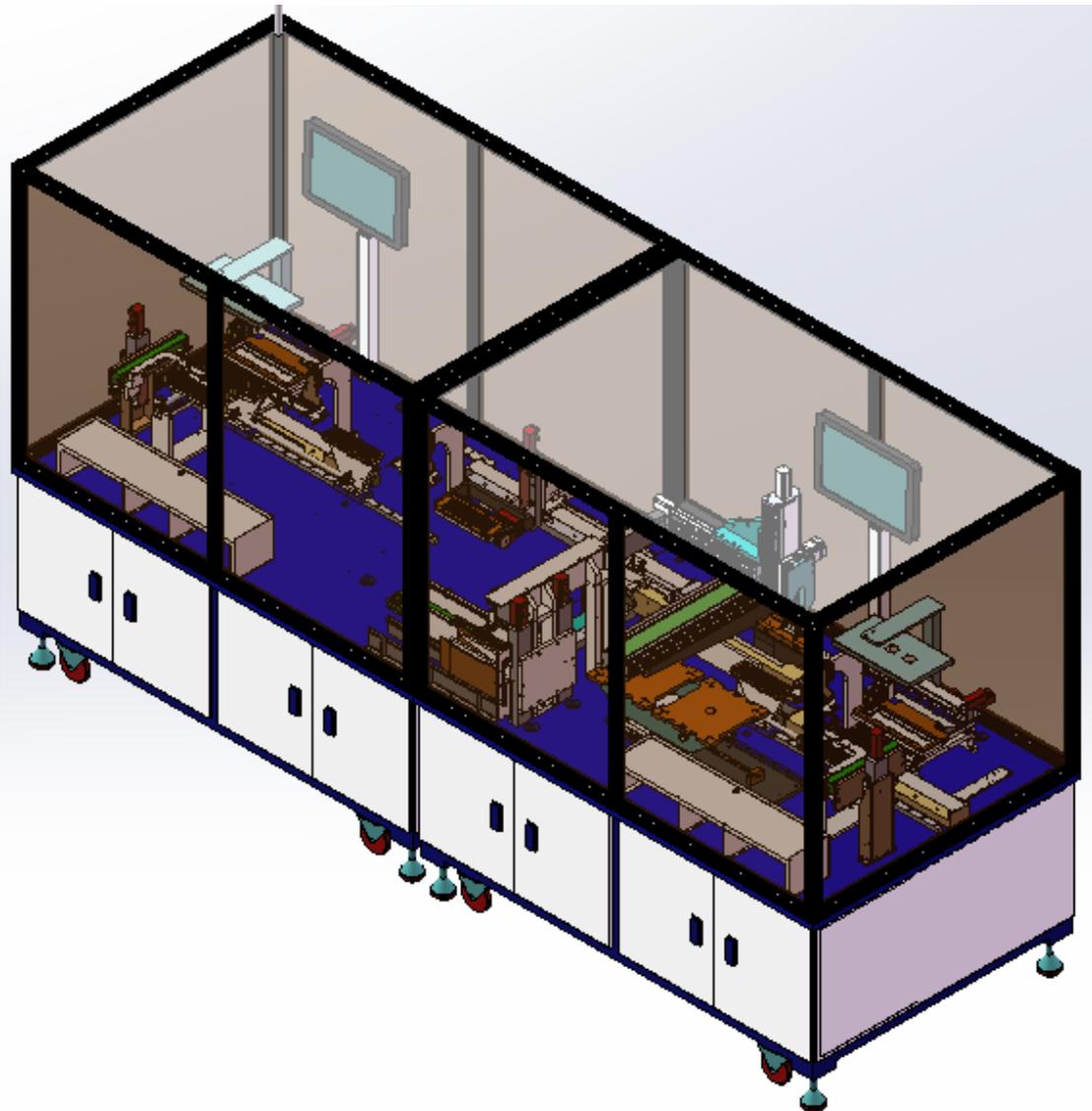


半導體乾冰清洗機： DIC-3000

產品說明：

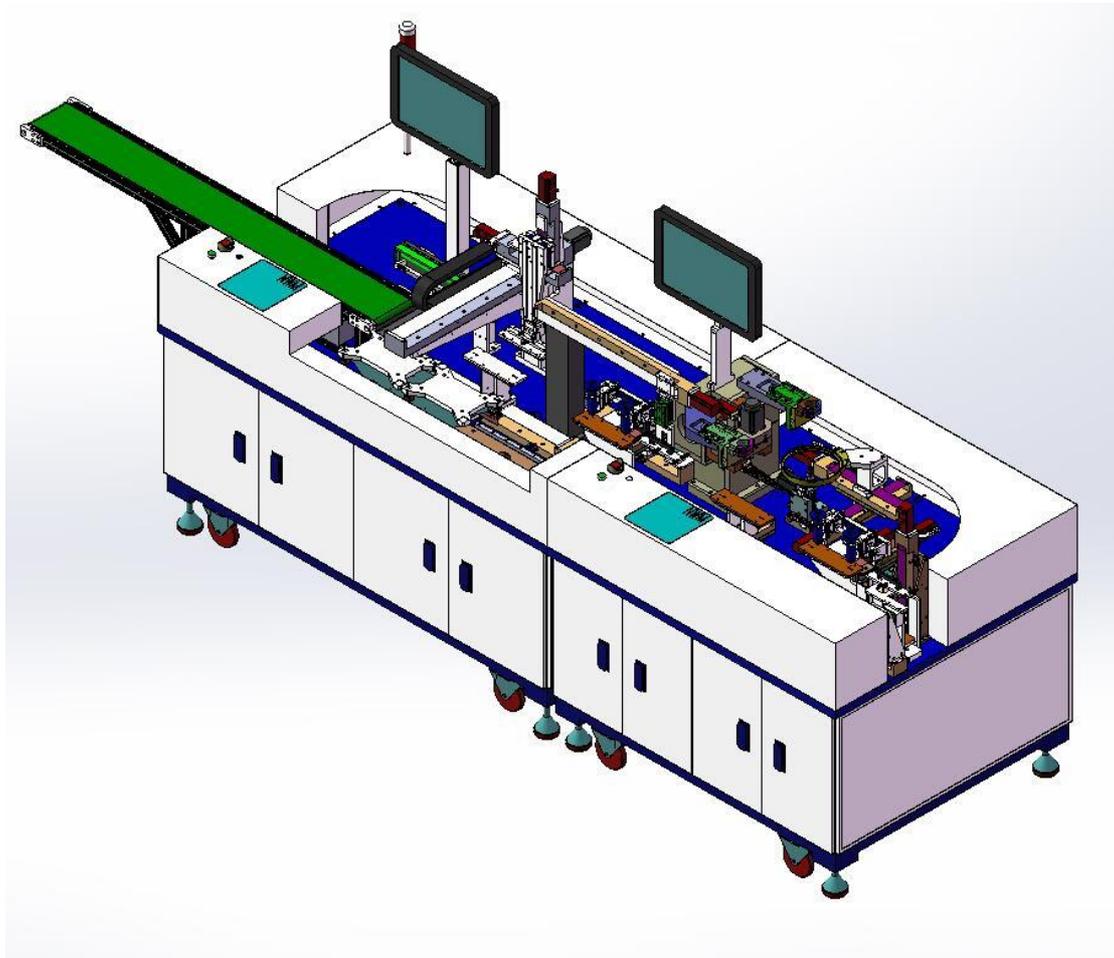
- 適用於激光切割後半導體材料清洗
- 自動上下料,產品掃描,系統連接
- 自動預熱除霜
- 智能化編程清洗，效率高，清洗效果好



半導體真空焊接爐：VWF-2000

產品說明：

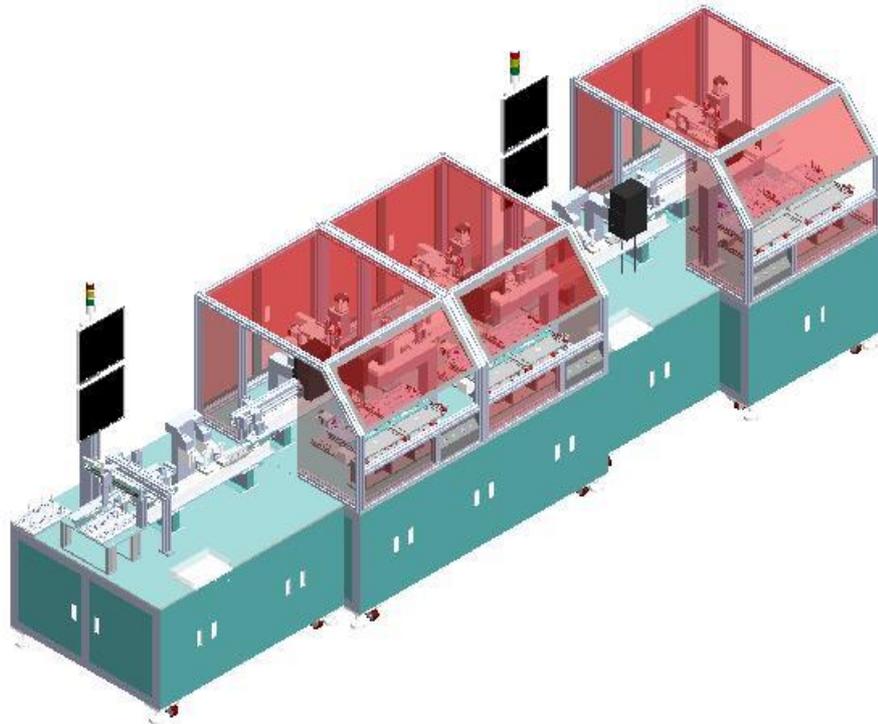
- 適用於半導體行業 IC 封装焊接
- 自動上下料,產品掃描,系統連接
- 真空焊接環境,有效減少氣泡產生
- 單獨冷卻區保證焊接質量



半導體晶圓&封裝鐳射雕刻機 SLM-3000

產品說明：

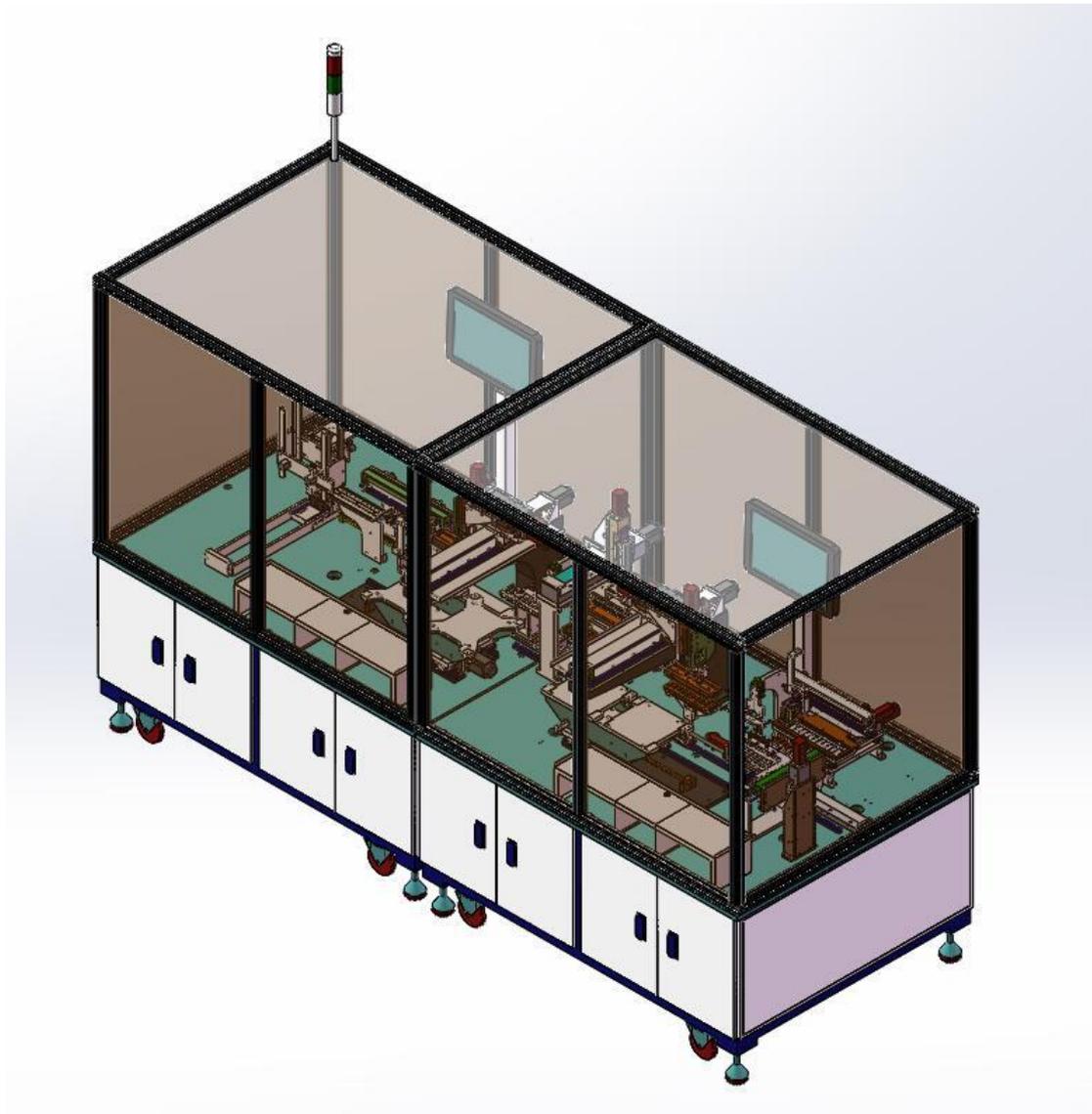
- 適用於半導體行業 IC,PCB 以及 ceramic 鐳射雕刻
- 可進行一維 / 二維條碼雕刻，
- 多頭鐳射模組訂製，提升產能
- 自動上下料,產品掃描,系統連接



半導體納秒 UV 鐳射鑽孔機 LD-2000

產品說明：

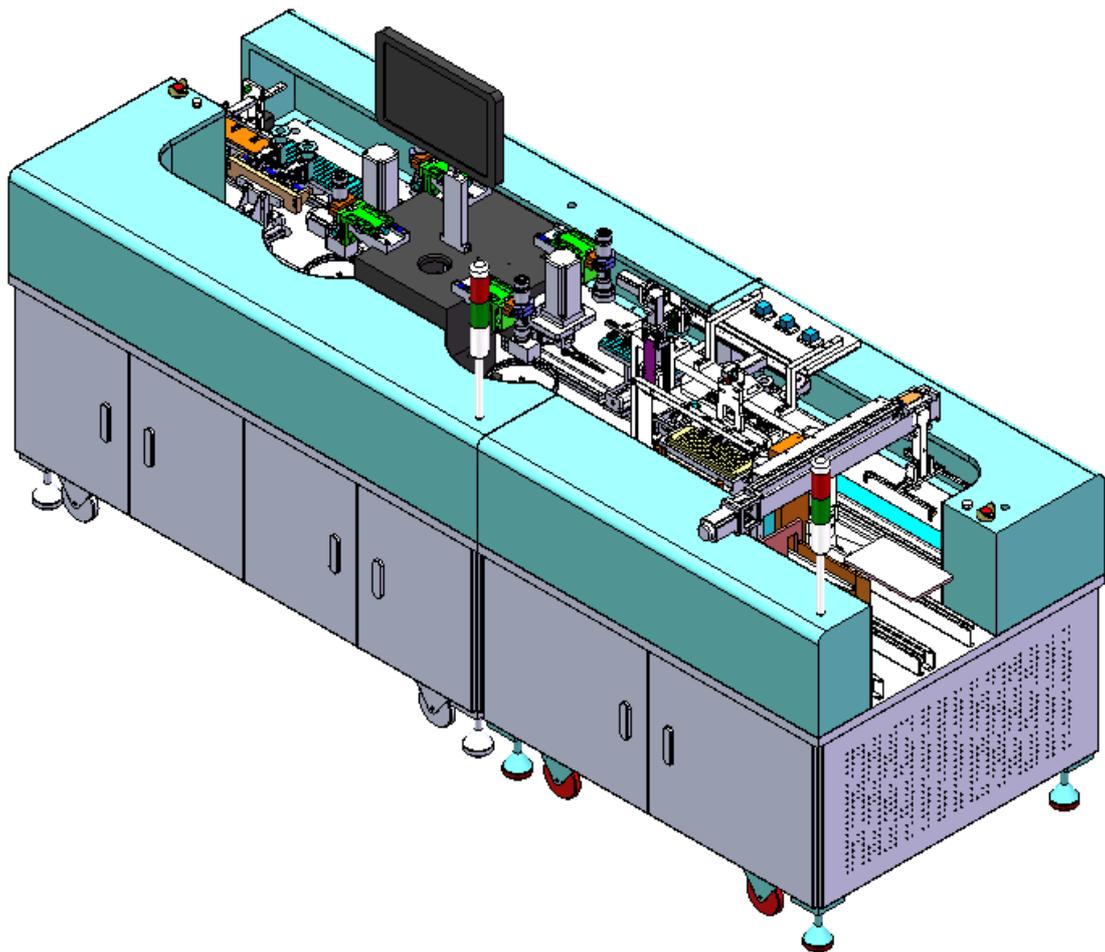
- 打孔效率高，經濟效益好
- 可獲得大的深徑比
- 無工具損耗
- 適合於數量多、高密度的群孔加工



半導體飛秒 GR 鐳射晶圓切割劃片機 LR-2000

產品說明：

- 高質量光束，焦點小，切割後晶粒質量優越，擁有極高的成品率；
- 整機高可靠性、高穩定性、高安全性；
- 先進的硬件控制技術和智能化軟件，圖像自動識別處理和定位功能。
- 應用於半導體製造行業單、雙台面玻璃鈍化二極管晶圓，單、雙台面可控硅晶圓，IC 晶圓切割等半導體晶圓片的切割劃片。



半導體皮秒 GR 柔性 FCB 切割機 LR-1000

產品說明：

- 輕鬆實現無應力切割，保護 PCB 及器件的安全。
- 低成本，幾乎無耗材，保養維護成本極低。
- 提升加工品質，輕鬆實現高精度的異形產品切割。
- 無需治具、輔助設施和耗材，快速對應新產品。
- 無毛刺、碳化物、無應力、無污染。

